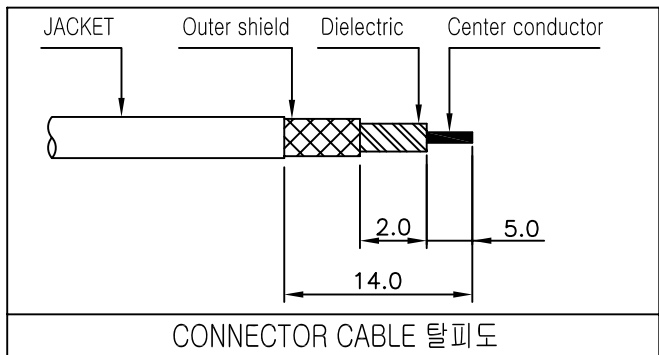
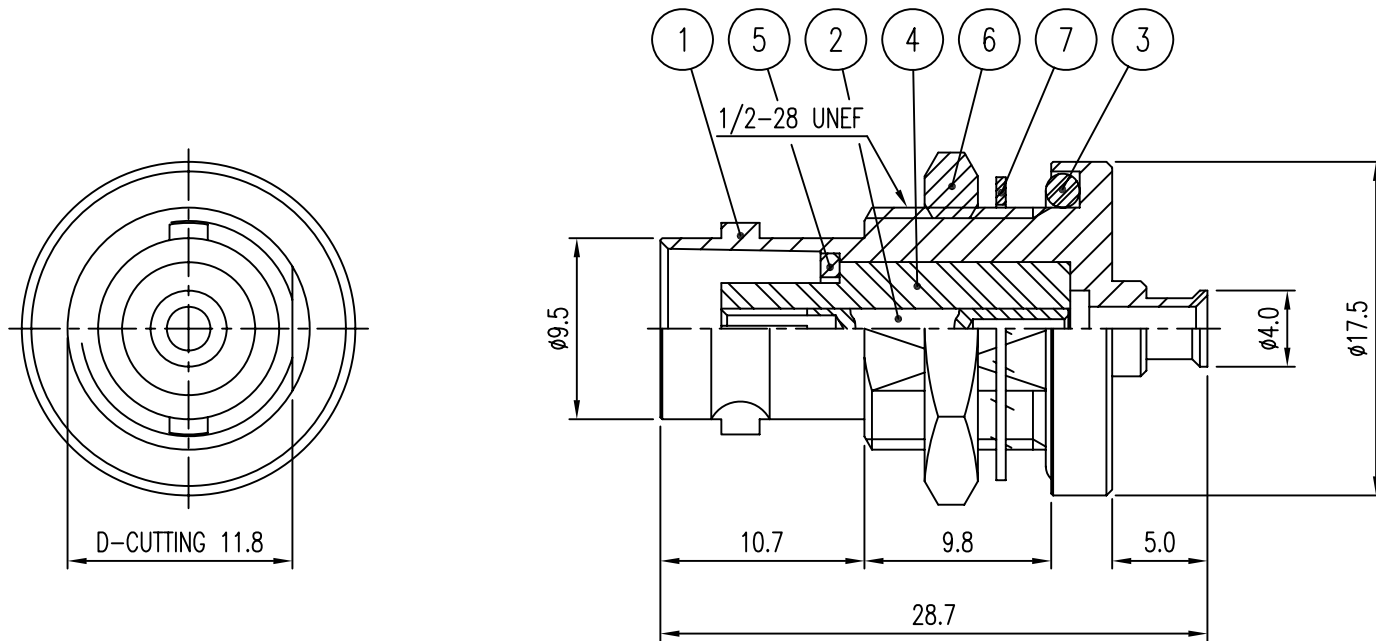


수 정 내 용									
ST	가공								
부호	내 용	수정자	승인자	년	월	일			
1	[첨변No.201605-0011] TEFLON 절연 능력으로 인한 치수 수정	H.J.LEE	I.C.KIM	2016.	05.	23.			
ST(개선)									



7	WASHER	1	BsS	Nickel Plate	DWA00022-5/1
6	NUT	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DNT00020-5/1
5	COVER	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DSR00051-5/1
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02768-N/1 DIN00451-N/1
3	GASKET	1	SILICON		DGK00036-N/1
2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DCT00491-5/1
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DBD000619-5/1
품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

소재가능재질	품번	품 명			수량	재 질	표면처리	비 고		
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	년월일	2016. 5. 23.				 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.				
	승인	I.C.KIM								
	재질	검도					도명	BNC50 CABLE JB (F/N) 85TP		
열처리	제도	H.J.LEE				A4	도번			CN00265-7/1
보호파막처리	작성부서	연 구 소								K325-330-000
	척도	3/1	단위	mm	총량					

